

这篇有关大面积 WLCSP 阵列热可靠性性能的论文将作为 WLCSP 跟踪论文的一部分进行展示

美通社亚利桑那州斯科特斯德3月10日电 California Micro Devices (Nasdaq: CAMD) 今天宣布, 该公司将在国际微电子与封装协会 (IMAPS) 第5届设备封装年度国际会议和展览 (5th Annual International Conference and Exhibition on Device Packaging) 上宣读一篇关于大面积晶圆级芯片尺寸封装 (wafer level chip scale package, 简称 WLCSP) 阵列热可靠性性能的技术论文。此次会议和展览将于2009年3月10日至12日在美国亚利桑那州斯科特斯德的 Radisson Fort McDowell Resort and Casino 举行。这篇论文将成为由晶圆级芯片尺寸封装论坛 (WLCSP Forum) 赞助的有关晶圆级芯片尺寸封装电路板可靠性的技术类跟踪论文的一部分。

#### WLCSP 热可靠性分析

这篇题为《Thermal Reliability Performance of Large Area WLCSP Arrays》(大面积 WLCSP 阵列热可靠性性能) 的论文探讨了先进的大面积 10 X 10 WLCSP 阵列的热可靠性性能。本文作者是 California Micro Devices 铸造工程与运营部门总监 Umesh Sharma 博士以及该公司的 Harry Gee、Phil Holland 和 Ram Swamy。Sharma 博士将于3月11日(周三)下午3:30宣读这篇论文。会议结束后, 可从 CMD 公司网站或 Wafer Level Chip Scale Forum 网站上下载这篇论文, 网址分别为 [www.cmd.com/applications/papers.php](http://www.cmd.com/applications/papers.php) 和 [www.wlcsforum.org](http://www.wlcsforum.org)。

#### California Micro Devices Corporation 简介

California Micro Devices Corporation 是一家面向手机、数字消费电子产品和个人电脑市场提供专用模拟及混合信号半导体产品的领先供应商。该公司的主要产品包括用于手机、数字消费电子产品(如数字电视)和个人电脑的保护设备, 以及用于手机显示屏的模拟及混合信号集成电路。垂询该公司及其产品详情, 请访问 <http://www.cmd.com>。

CMD 图标是 California Micro Devices 的商标。所有其它商标均属各自所有者财产。

消息来源 California Micro Devices Corporation

/联系人: California Micro Devices Corporation 的 Kyle Baker, 电话: +1-408-934-3117, 电  
邮: [kyleb@cmd.com](mailto:kyleb@cmd.com) /  
(CAMD)